

# 北京赛微电子股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉履行职责，科学决策，积极推动公司业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，扎实开展各项工作。在公司规范运作上，董事会根据监管部门的最新要求继续提升公司规范化运营和治理水平，优化公司的治理结构，完善风险防范机制，进一步健全公司规章制度，持续提升公司规范化运营和治理水平。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

### 一、公司 2025 年度工作总结

#### （一）整体经营情况概述

报告期内，公司继续聚焦发展主营业务 MEMS（微机电系统），并持续为下一步的产能扩充及爬坡做好准备；同时根据公司发展战略，延伸并购展诚科技，布局 IC 设计服务。

对于北京亦庄 MEMS 量产线，报告期内继续处于产能爬坡阶段，具有导入属性的工艺开发业务继续开展，带动着公司从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆产品类别持续增加。但由于部分原有量产客户订单在报告期内因下游市场需求变化产生较大波动，北京亦庄 MEMS 量产线的收入出现下滑。此外，北京亦庄 MEMS 量产线研发投入依然保持较高强度，运营支出存在刚性，叠加折旧摊销等因素，亏损较上年扩大。

对于瑞典 MEMS 产线（2025 年 7 月出表成为公司参股子公司），报告期内订单、生产与销售状况良好（尤其是 MEMS-OCS 晶圆的生产销售在本报告期实现大

幅增长), 继续实现了整体业务增长, 保持了良好的盈利能力。

近年来, 国际地缘政治环境发生深刻变化, 同时半导体产业在全球地缘政治博弈中的战略地位日益凸显, 经济全球化与国际产业链分工协作面临挑战。由于国际局势的日趋紧张及复杂化, 瑞典 Sillex 面临的不确定性因素显著增加。若公司继续维持对瑞典 Sillex 的控股地位, 其业务运营与发展面临的地缘政治相关风险及不确定性可能上升, 包括但不限于其与关键客户及供应商伙伴持续稳定合作的潜在挑战, 以及由此可能导致的瑞典 Sillex 经营风险和价值受损风险。为审慎应对复杂多变的国际形势, 最大程度缓解地缘政治环境变化带来的系统性风险, 切实维护上市公司及全体股东的长远利益, 经公司慎重研究, 决定出售瑞典 Sillex 控制权, 同时保留部分少数股权, 继续享有瑞典 Sillex 业务增长收益、保持境内外协作沟通纽带, 并为海外业务运营创造更具韧性的发展条件。本次重大资产出售已于 2025 年 7 月完成交割, 瑞典 Sillex 从公司的全资子公司转变成为公司的重要参股子公司。

2025 年 9 月, 公司完成对展诚科技 56.24% 股权的收购。本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00% 股权, 展诚科技成为公司控股子公司, 纳入公司合并报表范围。报告期内, 展诚科技 IC 设计服务保持良性发展, 实现盈利。

报告期内, 公司及相关子公司基于存量设备仍适度开展半导体设备业务, 贡献了一定的营业收入, 但由于缺乏上年的大客户销售, 且国内半导体设备市场竞争加剧, 公司 2025 年半导体设备业务较上年大幅下降了 82.69%。

与此同时, 报告期内公司管理费用大幅增长, 主要系确认瑞典 Sillex 因控制权出让交易触发的大额股权激励费用, 剔除该因素影响后, 管理费用较上年小幅增加; 财务费用上升, 主要系因报告期汇兑损失较上年同期增加; 销售费用略有下降; 资产减值损失大幅增加; 研发费用略有下降但继续处于较高投入水平。

报告期内, 公司实现营业收入 82,410.59 万元, 较上年下降 31.59%; 实现营业利润 138,017.82 万元, 较上年大幅增长 642.79%; 实现利润总额 138,010.57 万元, 较上年大幅增长 642.78%; 实现净利润 138,843.48 万元, 较上年大幅增长 643.94%; 归属于上市公司股东的净利润 147,345.41 万元, 较上年大幅增长 966.77%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,195.01 万元, 较上年大幅下降 79.30%。

报告期内, 公司基本每股收益 2.0123 元, 较上年大幅增长 966.62%; 加权

平均净资产收益率 25.27%，较上年优化 28.64%（绝对数值变动），主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润较上年大幅增长 966.77%。

本报告期末，公司总资产 893,942.24 万元，较期初上升 27.50%；归属于上市公司股东的所有者权益 673,438.65 万元，股本 732,213,134.00 元，归属于上市公司股东的每股净资产 9.20 元，较期初上升 36.90%。

报告期内，公司 2025 年 7 月完成对原全资子公司瑞典 Silex 控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典 Silex 由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，由此产生的非经常性损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重大影响；上述股权交易是公司营业收入下降、归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因。报告期内，非经常性损益对公司当期归母净利润的影响为 181,540.42 万元（主要影响因素为瑞典 Silex 控制权的出售），上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为 2,072.18 万元（主要影响因素为政府补助）。

## （二）主要业务情况

### 1、MEMS 纯代工业务发展情况

报告期内，公司 MEMS 业务收入下降，主要系公司 2025 年 7 月完成对原全资子公司瑞典 Silex 控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典 Silex 由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围；另一方面公司北京亦庄 MEMS 量产线的产能爬坡持续推进，除继续开展具有导入属性的工艺开发业务外，从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆代工品类持续增加，报告期内北京亦庄 MEMS 量产线工厂实现 MEMS 硅晶振及 OCS(Optical Circuit Switch 的缩写，即光链路交换器件)从工艺开发到小批量试生产的推进，但由于部分原有量产客户订单在报告期内因下游市场需求变化产生较大波动，北京亦庄 MEMS 量产线工厂的收入出现下滑。

报告期内，公司 MEMS 业务实现收入 68,409.97 万元，较上年下降 31.46%；其中，MEMS 晶圆制造实现收入 39,373.85 万元，较上年同期下降 39.98%，MEMS 工艺开发实现收入 29,036.12 万元，较上年同期下降 15.09%，上述变化的主要原因是：瑞典 Silex 2025 年 7 月由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。与此同时，由于北京亦庄 MEMS 量产线仍处于产能爬坡阶段，营收规模体量以及量产产品类别仍相对较少，部分原有量产客户订单在报

告期内因下游市场需求变化产生较大波动，北京亦庄 MEMS 量产线工厂的收入出现下滑，但持续累积各领域客户及晶圆产品类别。

报告期内，公司 MEMS 业务的综合毛利率为 37.86%，较上年同期上升 2.37%；其中 MEMS 晶圆制造毛利率为 34.50%，较上年同期基本持平，MEMS 工艺开发毛利率为 42.41%，较上年同期上升 2.51%，上述变化的主要原因是：对于 MEMS 晶圆制造，随着 MEMS 晶圆制造业务的逐步稳定发展，原材料、人工、制造费用等形成的成本结构日趋稳定，毛利率水平趋于稳定，未来需进一步释放规模效应；对于 MEMS 工艺开发，2025 年产品结构较上年同期有所变化，同时公司采取了有效的成本控制手段，毛利率较上年同期有所上升。整体而言，瑞典 MEMS 产线（2025 年 7 月出表成为公司参股子公司）的毛利率继续保持了较高水平，北京亦庄 MEMS 量产线仍处于产能爬坡阶段，其 MEMS 业务的综合毛利率较上年同期略有提升，公司 MEMS 业务最终在整体上保持了较好的毛利率水平。

报告期内，得益于 MEMS 应用市场的高景气度，并基于持续扩充的产线产能，公司积极开拓全球市场，并积极承接 MEMS 工艺开发及晶圆制造订单，持续服务于包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、光刻机、DNA/RNA 测序、高频通信、AI 计算、ICT、红外热成像、计算机网络及系统、社交网络、新型医疗设备等厂商以及通信计算、生物医药、工业汽车和消费电子等各细分领域的领先企业。

报告期内，公司瑞典 MEMS 产线升级改造完成后的产能逐步磨合且基于此前已收购的半导体产业园区，其自身的 MEMS 工艺开发及晶圆制造业务的产能保障能力均得到加强；公司北京亦庄 MEMS 量产线持续扩大覆盖不同的产品及客户，积极推进产能及良率爬坡，并适时逐步扩充产能。公司虽已于 2025 年 7 月完成瑞典 Silex 控制权出售的交割，但随着北京产线整体运营状态的持续提升，以及公司正在推进的怀柔 MEMS 中试线布局，公司仍拥有不同定位的合格产能，不同产线在产能、市场等方面可以实现协同互补，公司有望在纯 MEMS 代工领域仍保持重要地位。

## 2、IC 设计服务业务发展情况

2025 年展诚科技实现营业收入 21,148.38 万元，归母净利润 2,216.41 万元，保障提升 IC 设计服务业务基本盘的同时，推进了 EDA 软件开发。报告期内，展诚科技紧抓算力及 AI 芯片发展的重要机遇期，优化自身技术，夯实绑定大客户战略，大力开发新客户，实现了技术优化升级与包括海外市场的业务开拓，并提

前布局 3nm 以下技术储备与积累。同时，展诚科技积极延伸业务赛道，力争细分领域的突破，并不断打造自身在不同芯片领域从架构设计到版图验证的一站式服务能力和全方位服务体系，关注和兼容国际主流技术、工具、格式，积极捕捉商业机遇，为将来助力客户降低研发成本、缩短上市周期做好了扎实准备。报告期内展诚科技各业务模式的发展情况如下：

#### （1）off-site 模式发展情况

报告期内，展诚科技在 off-site 模式依托远程网络专业工具、安全远程协作体系的完善和普及，借助标准化的设计流程、跨地域的资源整合能力，在芯片设计、验证、标准化 IP 开发与验收、设计数据校验检查等项目流程中持续优化运营效率，有效降低了远程协作的沟通成本。off-site 模式是展诚科技服务众多客户、承接批量标准化需求的重要模式。

#### （2）on-site 模式发展情况

报告期内，展诚科技在 on-site 模式持续深化场景化适配能力，针对客户先进工艺节点芯片设计、高复杂度混合模块等对实时协同、工艺深度对接要求高的需求，进一步强化驻场团队的专业配比度，提升快速响应速度，通过与客户的无缝联动，在项目中实现了高效协作和高质量交付。on-site 模式是展诚科技 IC 设计服务业务发展的重要模式。

#### （3）odc 模式发展情况

报告期内，在 odc 离岸开发中心模式方面，展诚科技搭建专属化、定制化的离岸团队，推进规模化落地与精细化运营，围绕芯片设计客户的长期持续性需求，实现了团队与客户设计规范、工艺要求、工具链的深度适配，同时展诚科技通过建立远程管理体系、人才培养机制与数据安全防护体系，有效平抑了高端人才稀缺等问题，初步形成了成本优势与交付效率的双协同。

### 3、研发情况

报告期内，公司继续重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。公司 MEMS 纯代工业务及 IC 设计服务业务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也需要公司进行重点、持续的研发投入。2025 年，公司共计投入研发费用 39,272.97 万元，占营业收入的 47.66%，金额在上年高基数的情况下有所下降，继续保持了较高的投入强度。

### 4、投融资情况

报告期内，公司为实现产业目标、把握合作机遇、更好地服务于 MEMS 主业的发展，基于过往已有布局、根据长期发展战略继续开展投融资活动：（1）股权投资方面，根据公司业务发展战略和规划，公司进一步提高了对赛莱克斯北京的持股比例，收购了展诚科技 56.24% 股权，参与投资设立初芯微，收购芯东来部分股权，并小比例参与投资了多家半导体产业链相关公司、提升了光谷信息持股比例；（2）股权转让方面，基于地缘政治及国际局势的日趋紧张及复杂化，公司决策转让瑞典 Silex 控制权，同时保留部分少数股权；（3）产业基金方面，持续推动北京传感基金、深圳智能传感基金在智能传感领域的项目投资，继续跟踪半导体产业基金、北斗产业基金的投资与投后情况，关注赛微私募基金的运行情况；（4）融资租赁方面，赛莱克斯北京、赛积国际继续执行相关融资租赁交易；（5）银行授信及并购贷款方面，公司及子公司根据经营发展中的资金需求，积极向相关银行申请综合授信额度及并购贷款，扩大资金使用空间，降低财务资金成本。

## 二、董事会的运行情况

### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开了 12 次董事会。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

1、2025 年 3 月 19 日，召开第五届董事会第十三次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
3	《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
4	《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
5	《关于〈2024 年年度审计报告〉的议案》
6	《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
7	《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
8	《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
9	《关于〈2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计〉的议案》
10	《关于〈2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
11	《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

12	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
13	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
14	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
15	《关于〈2024 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告〉的议案》
16	《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
17	《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
18	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
19	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
20	《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
21	《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

2、2025 年 4 月 10 日，召开第五届董事会第十四次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于聘任公司总经理的议案》
2	《关于聘任公司财务总监的议案》

3、2025 年 4 月 24 日，召开第五届董事会第十五次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

4、2025 年 6 月 13 日，召开第五届董事会第十六次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2	《关于公司重大资产出售方案的议案》（逐项审议）
2.01	本次交易方案概述
2.02	本次交易具体方案——交易对方
2.03	本次交易具体方案——交易标的
2.04	本次交易具体方案——交易价格及支付方式
2.05	本次交易具体方案——债权债务转移
2.06	本次交易具体方案——员工安置
2.07	本次交易具体方案——决议有效期
3	《关于全资子公司瑞典 Sillex 变更认股权证行权方案的议案》
4	《关于〈北京赛微电子股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》
5	《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》
6	《关于本次重大资产出售定价的意见及公平合理性说明的议案》

7	《关于本次重大资产出售签署附生效条件〈股份买卖协议〉的议案》
8	《关于公司本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条的相关规定的议案》
9	《关于公司本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》
10	《关于公司本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
11	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
12	《关于公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
13	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
14	《关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的议案》
15	《关于本次重大资产重组中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
16	《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
17	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》
18	《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的议案》
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
20	《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025年6月30日，召开第五届董事会第十七次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2	《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
3	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4	《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
5	《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

6、2025年7月16日，召开第五届董事会第十八次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
4	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
5	《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
6	《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
7	《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

8	《关于修订〈战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》
9	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
10	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
11	《关于修订〈内部信息保密制度〉的议案》
12	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
13	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
14	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
15	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
16	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
17	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
18	《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
19	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
20	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
21	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
22	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
23	《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》
24	《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》
25	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
26	《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
27	《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
28	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
29	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
30	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
31	《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
32	《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2025 年 8 月 19 日，召开第五届董事会第十九次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于收购青岛展诚科技有限公司 56.24%股权的议案》

8、2025 年 8 月 26 日，召开第五届董事会第二十次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
2	《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
3	《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
4	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
5	《关于控股股东为公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供关联

	担保的议案》
6	《关于为子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供担保的议案》

9、2025年9月10日，召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于全资子公司向银行申请并购贷款的议案》
2	《关于控股股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》
3	《关于为全资子公司申请银行并购贷款提供担保的议案》

10、2025年10月27日，召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

11、2025年11月18日，召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
2	《关于拟使用自有资金进行证券投资的议案》
3	《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

12、2025年12月5日，召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过以下议案。

序号	议案名称
1	《关于向银行申请并购贷款的议案》
2	《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3	《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
4	《关于控股股东为公司申请银行并购贷款及为控股子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
5	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开4次股东会，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。主要如下：

公司董事会已按股东会的决议，聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构、执行2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、完成重大资产出售、贯彻落实修订后管理制度的执行事宜等事宜。

### （三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事王玮先生、刘婷女士、付三中先生认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，列席股东会，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、内部控制、公司治理、重大资产出售、资产收购等事项作出了客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

## 三、公司展望及 2026 年度经营计划

公司针对未来的展望与规划是公司基于当前宏观经济形势和所处行业市场环境，对可预见的将来作出的发展计划和安排。投资者不应排除公司根据经济形势、市场环境变化和经营实际状况对发展目标进行修正、调整和完善的可能性。

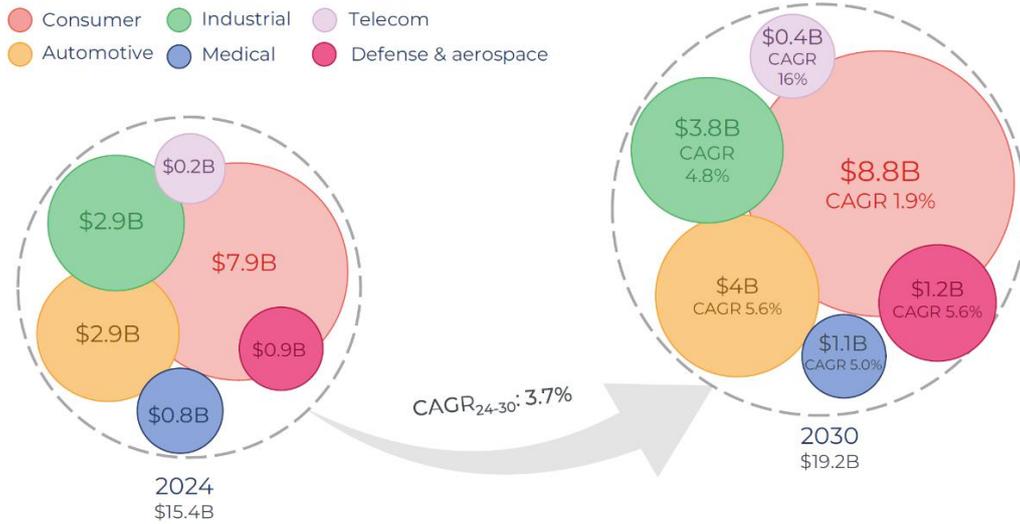
### （一）行业格局和趋势

全球集成电路行业整体发展前景广阔、长期向好，AI 芯片、HBM 存储、先进封装正成为核心增长引擎，此外集成电路行业分工逐步细化，技术上也由单纯追逐先进制程转向 Chiplet、3D 堆叠、异构集成等系统集成创新。包含公司 MEMS 纯代工和 IC 设计服务在内的集成电路行业，成长预期明确，具备高确定性发展前景。

#### 1、MEMS 行业格局和趋势

随着万物互联与人工智能的兴起，作为集成电路细分行业的 MEMS 获得了更广阔的市场空间和业务机会。传统的传感器、执行器和无源结构器件目前正逐步被替代，这使 MEMS 技术的渗透率得以进一步提高。根据世界权威半导体市场研究机构 Yole Development 发布的《Status of the MEMS Industry 2025》，全球 MEMS 市场规模将由 2024 年的 154 亿美元增长至 2030 年的 192 亿美元，CAGR（年均复合增长率）为 3.7%。

## MEMS MARKET FORECAST, BY END-MARKET

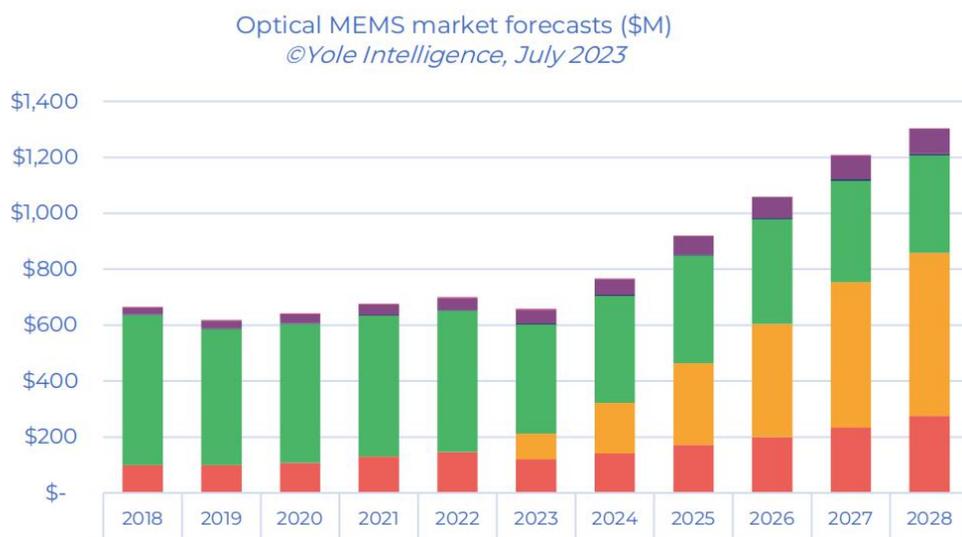


图片来源: Yole Development

### (1) 光学 MEMS 领域

在光学市场,人工智能对高速通信的需求,促进了硅光技术和 MEMS 硅光子产品的迅速发展。硅是集成电路制造中常见的材料,但硅材料发光性差,导致生产出的调制器占用空间较大。为了解决这一问题,业界探索基于环形谐振器的调制器,但光谱响应较窄,容易出现变化,需要额外的移相器来进行波长调谐,导致损耗过大。MEMS 技术可以通过构建紧凑、宽频、快速、低损耗、低功耗的模块解决以上问题,制造各类硅光子器件,助力硅光子实现广泛应用和市场突破,如可调谐激光器、耦合器、移相器、光开关等。随着 AI 技术的快速发展,Meta、Open AI、微软、谷歌、百度、阿里、科大讯飞、华为公司等纷纷推出 LLM (大语言模型) 等各类 AI 模型,引爆全球算力及相关芯片、服务器、数据中心需求。随着大型 AI 模型参数数量级从百亿跃升到千亿级别,对计算能力和内存资源的需求也随之急剧增长,业界目前普遍采用构建算力集群的方式去满足相应需求,并使用数千个图形处理器 (GPU) 训练运行。相关训练可能耗费数周时间,价值高昂,因此找到提高训练效率的方法至关重要。与传统交换机方案相比,基于 MEMS 的光交换方案在 GPU 之间的数据交换速率及功耗等方面都具备突出优势,对于降低机器学习训练的时间和费用有很大帮助。随着谷歌在张量处理单元 (TPU) OCS 的成功应用以及海量算力需求的持续释放, MEMS-OCS 有望在业界得到推广使用,包括新建及传统数据中心,这将催生新型 MEMS 硅光产品的巨量需求。根据

Yole 此前预测的数据，预计 2023-2028 年，光学 MEMS 市场将从 6.57 亿美元增长至 13.04 亿美元。



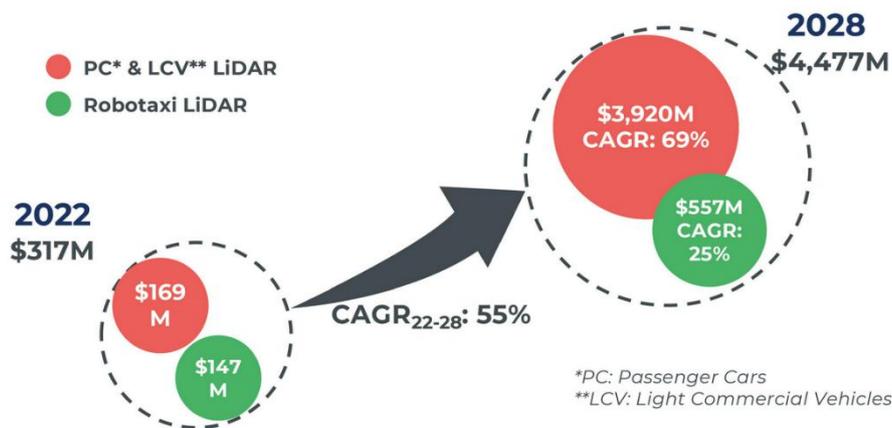
图片来源：Yole Development

## (2) 汽车 MEMS 领域

在智能化、电动化、网联化发展的背景下，汽车 MEMS 市场将出现较为强劲的增长。中国新能源汽车产量快速增长，智能化程度不断提高，带动了激光雷达和微振镜等相关 MEMS 器件的需求。激光雷达又可分为机械式、混合固态等类别，采用 MEMS 技术的混合固态技术显著缩小了雷达体积和功耗，具备运动部件少、可靠性高、扫描频率快、规模化生产等优势，后者的核心扫描部件即为 MEMS 微振镜。根据 Yole 的数据预测，2022-2028 年全球汽车激光雷达市场预计将从 3.17 亿美元增长至 44.77 亿美元，CAGR（年均复合增长率）高达 55%。

## 2022-2028 LIDAR MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

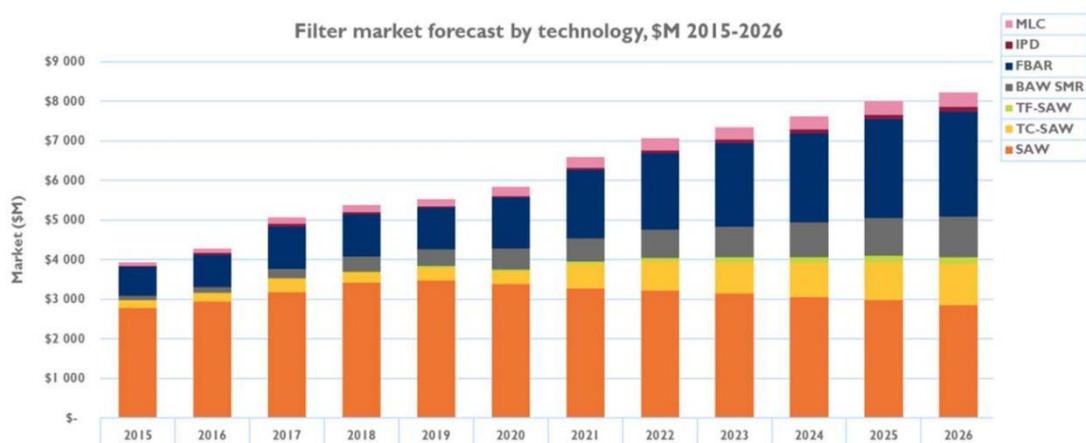
Source: LiDAR for Automotive 2023 report, Yole Intelligence, 2023



图片来源: Yole Development

### (3) 通信 MEMS 领域

在通信市场，信号之间的干扰问题需要滤波器进行解决，且在发射及接收通路中都需要使用，所以滤波器是射频系统中最重要元器件，直接影响各频段信号通信质量。在 5G 及更高频通信时代，BAW 滤波器具有高频率和宽频带的技术优势，可以提供更低的插入损耗，更好的选择性，更高的功率容量，更大的运行频率，更好的静电放电保护，在高频应用场景有着更佳的表现。根据 Yole 发布的《BAW Filter Comparison 2022》，2026 年滤波器市场将增长至 80 亿美元以上。2026 年，SAW 滤波器在智能手机市场的占比将从 2020 年的 64% 降至 50%，同时 BAW 滤波器占比将增长至 45%。

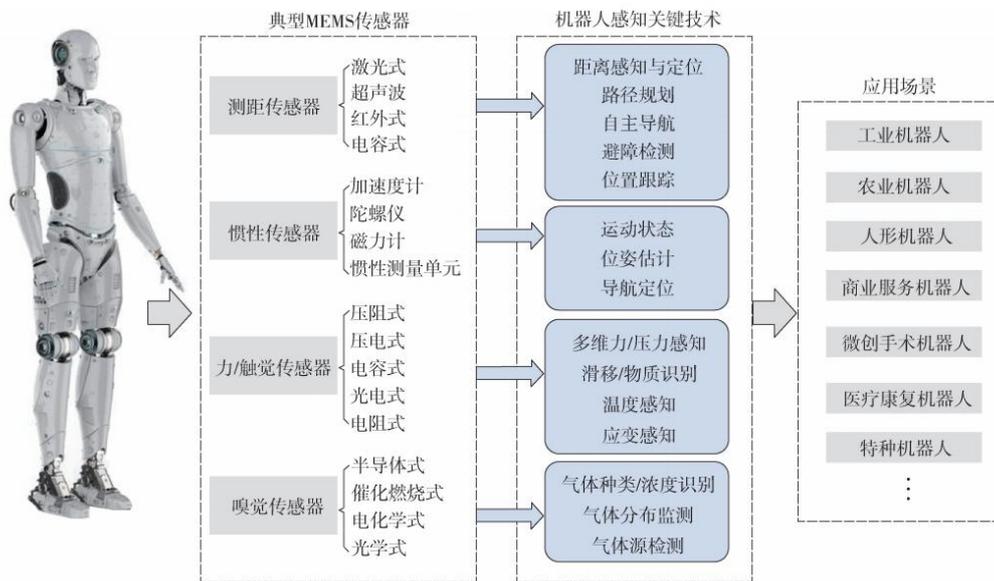


图片来源: Yole Development

#### (4) 机器人领域

在机器人领域, MEMS 传感器具有重要作用。MEMS 惯性测量单元、加速度计和陀螺仪, 能够帮助机器人精确感知自身姿态和运动轨迹; MEMS 测距传感器/激光雷达可以实时监控机器人的位置以及与障碍物的距离, 帮助机器人进行路径规划和避障; MEMS 力传感器有望应用于机器人手臂的力反馈控制, 帮助机器人感知物体抓取施加力量, 实现精细化操作; MEMS 温湿度、气体传感器, 也有望在机器人领域得到应用。对于手术机器人而言, MEMS 传感器能够提供精确的运动和力反馈, 帮助医生进行微创手术操作。对于工业机器人而言, MEMS 传感器有助于更好地进行装配、焊接及搬运等工作, 提高生产效率和精度。此外, 工信部在《人形机器人创新发展指导意见》中指出: “人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术, 有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品, 将深刻变革人类生产生活方式, 重塑全球产业发展格局。” 机器人市场有望带动相关 MEMS 传感器需求的持续增长。

#### 典型 MEMS 传感器在机器人领域中的应用



图片来源: 刘会聪, 王凤霞, 李东升, 迟文政, 孙立宁. 基于 MEMS 传感器的机器人感知技术研究现状与发展趋势[J]. 智能感知工程, 2024, 1(1):14-24.

#### (5) 商业航天领域

在商业航天领域, MEMS 惯性测量单元、加速度计和陀螺仪能够为商业火箭、卫星与航天器提供高精度姿态感知, 保障入轨精度与在轨稳定运行; MEMS 压力、

流量与液位传感器可实时监测推进剂状态、箭体/星体内环境参数，支撑动力系统与热控系统安全可靠工作；MEMS 微振传感器、射频 MEMS 器件可用于航天器结构健康监测、星间/星地通信链路与相控阵天线调谐，提升信号质量与系统稳定性；MEMS 温度、真空传感器也广泛适配太空极端环境，保障平台与载荷长期稳定工作。MEMS 传感器有望以微型化、低功耗、高可靠与低成本优势，成为卫星大规模组网的基础器件，显著降低研制与发射成本；对于商业运载火箭而言，MEMS 传感器助力起飞、入轨与回收全流程精准控制，提升发射成功率与复用能力。商业航天的快速发展与大规模建设，将持续带动高可靠 MEMS 传感器需求高速增长。

### 典型 MEMS 传感器在商业航天领域中的应用



图片来源：赛微电子

与传统集成电路产业类似，从 MEMS 产业价值链来看，根据行业内企业提供的产品或服务，主要可以分为设计、制造和封测三个环节。其中，MEMS 制造处于产业链的中游。该行业根据设计环节的需求开发各类 MEMS 芯片的工艺流程并实现规模生产，兼具资金密集型、技术密集型和智力密集型的特征，对企业资金

实力、研发投入、技术积累等均提出了极高要求。目前而言，IDM 企业凭借长期的行业积累、技术实力以及客户基础仍主导着 MEMS 加工制造，但也逐渐出现一些新的变化，一方面 IDM 企业受到来自升级产业线以及降低成本维持利润的双重压力，市场中已出现 IDM 企业将制造环节外包的情况；另一方面，MEMS 产品应用的爆发式增长需要不同领域、不同行业的新兴 MEMS 公司参与其中，但巨额的工厂建设投入、运维成本以及 MEMS 工艺开发、集成的复杂性形成了较高的行业门槛，阻碍了市场的持续扩张。而随着 MEMS 产业的大规模发展，各环节开始出现明显的分工趋势。参照 IC 产业的发展历程，尽管目前过半的 MEMS 业务仍然掌握在 IDM 企业中，但 MEMS 生产的大批量、标准化需求使得 MEMS 产业的专业化分工将成为重要的发展趋势。

### MEMS 产业图示



图片来源：Yole Development

随着消费类电子和互联网的兴起，MEMS 产品种类增加、市场规模扩大，行业对产品生产周期的缩短及生产成本的降低提出了更高要求，同时 MEMS 工艺研发费用迅速上升以及未来建厂费用高企促使更多的半导体厂商将工艺开发及生产相关的制造环节外包，纯 MEMS 代工厂与 MEMS 产品设计公司合作开发的商业模式将成为未来主流行业业务模式。类似于传统集成电路行业发展趋势，MEMS 产业将逐步走向设计与制造分立、制造环节外包的模式。从趋势上看，全球 MEMS 代工业务，尤其是纯 MEMS 代工业务有望快速扩张；从结构上看，纯 MEMS 代工业务在 MEMS 代工业务中所占比重有望逐步升高。

2014 年底，国家集成电路基金成立，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，以充分发挥国家对集成电路产业发展的引导和支持作用。国家集成电路基金主要围绕国内细分领域龙头企业进行投资布局，期望以龙头企业为载体打造资源整合平台，协调产业链上下游融合。作为国内首支集成电路产业股权基金，国家集成电路基金对于半导体行业具备深刻的理解和专业认知，拥有充足资金、行业资源及专业的投资团队作为项目投资及投后管理的坚实后盾。除直接对公司控股子公司赛莱克斯北京增资 6 亿元并持股 30%外（后因极芯传感对赛莱克斯北京增资，该持股比例变更为 28.5%，目前持股比例 19%），国家集成电路基金参与公司 2019 年非公开发行股票约 10.28 亿元，以进一步支持公司推进建设“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”，打造整合国内外产业资源的平台型企业，提升公司 MEMS 行业的市场地位和全球影响力。

## 2、IC 设计服务行业格局和趋势

在全球化集成电路蓬勃发展过程中，随着芯片制程不断精进、系统复杂度呈指数级提升，芯片研发已演变为高度专业化、知识密集型的独立赛道——IC 设计服务与 EDA 工具服务由此成为产业链不可或缺的行业。IC 设计服务是连接技术、工艺与产品的桥梁，大幅降低了芯片研发门槛、缩短周期、控制成本与风险；EDA 是芯片设计的工业软件，决定设计效率与上限，二者共同支撑芯片从算法到流片的全流程实现，是集成电路芯片设计产业创新效率的关键保障。当前，IC 设计服务行业凭借全流程技术解决方案与定制化服务能力，深度渗透通信计算、消费电子、工业汽车等多个核心领域；而国内 EDA 市场虽然仍由新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence）和西门子（Siemens）EDA 三大巨头主导，但国产力量正加速突围态势，致力于实现国产替代。

通信计算领域是当下 IC 设计服务的前沿领域。通信计算领域的卫星通信普及和数据中心算力升级，推动着高性能计算 IC 设计服务需求激增。具体来讲，IC 设计服务通过先进制程（7nm 及以下）设计、异构集成技术突破，助力通信计算芯片实现算力提升与功耗优化；同时 IC 设计服务为量子计算、光电子芯片等前沿领域提供前瞻性设计解决方案，支撑数字基础设施建设，大力推动着通信计算领域向高速率、高算力、低延迟升级，已经成为通信计算领域高速发展不可或缺的重要力量。报告期内，展诚科技通过高质量的服务与国内通信计算大客户实现了深度绑定，为公司业绩提升提供了源源不断动力。

消费电子领域为 IC 设计服务的传统基础阵地。近年来，消费电子向智能化、高端化升级趋势明显，智能手机、智能家居、可穿戴设备等终端对芯片的高性能、低功耗、小型化需求日益迫切。IC 设计服务通过优化芯片架构、提升制程适配能力，助力终端厂商实现产品差异化竞争，无论是高端手机的影像芯片、快充芯片，还是智能家居的物联网连接芯片，都离不开 IC 设计服务的配套能力。伴随消费电子换新潮与物联网普及，该领域需求将持续稳定增长。报告期内，展诚科技在消费电子电源管理等方面持续服务相关客户，巩固了公司在消费电子领域的行业领先地位。

工业汽车领域是目前 IC 设计服务的重要增长极。随着汽车智能化、网联化转型，当前自动驾驶正向 L3+ 级别演进，工业汽车领域车规级芯片对功能安全、可靠性的严苛标准，要求 IC 设计服务向高安全性、高兼容性升级。众多 IC 设计服务公司当下正通过提供车规级 SoC 芯片全定制设计、Chiplet 异构集成方案及相关合规验证服务，提升自身在工业汽车芯片领域的话语权，助力车企突破自动驾驶感知、决策、控制核心芯片瓶颈，推动车载娱乐、车联网模块的轻量化设计，降低研发成本与周期。报告期内，展诚科技服务在工业汽车领域客户持续推进终端应用，包括但不限于汽车音频功放、电机驱动等。

除此之外，IC 设计服务在工业控制、物联网、航空航天等领域也发挥着不可替代的作用。在工业控制领域，IC 设计服务企业为工业 MCU、PLC 芯片提供设计服务，支撑智能制造转型；在物联网领域，通过轻量化芯片设计，IC 设计服务助力海量终端连接；在航空航天领域，提供高可靠性、抗干扰芯片设计方案，IC 设计服务保障航空航天设备稳定运行。

综上所述，公司主要业务所处行业呈现朝气蓬勃的发展趋势，拥有良好政策环境、广阔发展前景与巨大的发展潜能。公司将积极把握行业趋势，整合各项资源，力争实现业务的快速发展。

## （二）公司的发展战略

公司的长期发展战略为：基于当前国际局势紧张及日趋复杂化的考量，对于经济全球化与国际产业链分工协作可能面临的挑战，推动一站式服务在客户拓展方面的重要作用，同时在境内外布局建立兼具“工艺开发”与“晶圆制造”功能的制造产线，以同时满足境内外客户的不同需求，致力于形成可支持“内循环”、兼顾“双循环”的一站式综合服务体系；同时积极进行产业投资布局，最终致力

于成为一家立足本土、国际化经营的知名半导体专业服务厂商。

### （三）公司的具体经营计划

2025 年，面向万物互联与人工智能时代，公司已形成以半导体为核心的业务格局，聚焦发展 MEMS 核心业务，并在报告期内稳健推进了各项工作，即公司 2025 年的发展战略和经营计划根据外部环境进行了适应性调整并得到有效执行。

2026 年，公司将继续落实总体发展战略及董事会制定的经营方针，以技术及市场为导向，聚焦发展主营业务，统筹各项资源，继续提高境内 MEMS 纯代工业务的承接能力，同时积极开拓 IC 设计服务及 EDA 工具服务，在研发、生产、市场等方面进行全面加强。2026 年，公司经营计划将继续围绕以下几个方面进行实施：

#### 1、技术创新

为保持和提高技术水平及创新能力，公司将继续重视研发投入，加大力度研究可应用于人工智能、数据中心、光学传输、高频通信、生物医药、工业汽车等领域的 MEMS 工艺制造技术和 IC 设计服务，为万物互联与人工智能时代提供更丰富的基础硬件支持；重视技术开发与创新向上游基础器件与下游终端设备的延伸；逐步建立整体研发体系，促进子公司之间的资源共享与技术互补，共同提高基础性及应用性研发工作的效率；积极参与产学研合作，组织实施重点研发计划项目。

#### 2、生产制造

2026 年，公司将持续为客户提供高质量、高标准的产品和服务，提升良率及客户满意度；持续满足 ISO 9001 质量管理等体系要求和北京亦庄 MEMS 量产线 IATF 16949 认证；重视积累现有产品的生产经验，推动更多产品导入量产，不断提高工艺技术水平；加大职业健康安全风险识别与防范，严格管理有害物质，维持安全生产；在保障生产质量的前提下，推动降低采购成本和节能减排，减少碳排放和水资源消耗，保护生态环境。

#### 3、市场营销

市场方面，在现有架构和业务布局的基础上，加强与客户的协调，继续完善 MEMS 产业生态，深化全国重点区域与海外重点市场布局；重视梯队建设，强化销售及技术支持人员的培训，提高业务水平；丰富产品资料及销售工具，加强市场推广，强化展会与行业联盟的纽带作用；继续建立整体市场营销体系，促进境内外子公司之间服务与销售网络资源的共享，提升整体市场营销实力。

#### 4、人力资源

落实绩效评价体系和人才激励机制，持续提升工作效率；维护并强化高素质的人才队伍，重视梯队建设；加强重点岗位的招聘力度，积极做好高端人才引进和服务保障工作；构建科学的人才培养体系，提供个性化、多类别培训，充分发挥员工潜力；搭建多元沟通渠道，构建和谐、开放的职场环境，保障员工合法权益；关怀员工生活，增强员工归属感，营造积极向上、团结友爱的企业文化氛围。

#### 5、财务与风险控制

积极主动对接资本市场，了解资本市场动态，获取推介机会，有效提升企业运营能力；继续推动重点业务子公司的债权融资、支持旗下参控股子公司融资；继续实施针对企业与基金的相关产业投资；严格实施内控管理制度，强化审计监督，强化法务培训，系统识别、分析和防范各类经营风险；通过制度完善、管理提升和规范运营，保障公司长期稳健发展。

#### 6、内生与外延发展

公司将根据发展战略的需要，同等重视内生与外延发展。一方面，公司不断加大自主投入、推动内生发展，充分关注并促进各业务板块及各子公司的发展；另一方面，如出现新的合适标的，公司可考虑利用上市资本平台实施并购重组，提高产业链及业务拓展效率，实现跨越式发展。

#### 7、产能储备及产业链延伸

一方面，公司将积极拓展 IC 设计服务、EDA 软件工具、MEMS 纯代工、MEMS 封装测试业务之间的协同效应，在面向芯片设计公司提供不同服务的同时，积极发挥其中单项业务为其他业务协助拓展业务的导入功能。

另一方面，公司将结合 MEMS 纯代工业务中“工艺开发”与“晶圆制造”紧密结合的特点，依托于已建成并持续扩充产能的北京亦庄 MEMS 量产线，继续建设面向现实及未来需求的规模量产线；同时推动建设怀柔 MEMS 中试线，通过提供工艺开发及小批量代工服务，为 MEMS 规模量产线储备并导入相应的客户及产品，最终提高公司的综合工艺开发及规模量产能力。

此外，基于公司既有 MEMS 制造业务基础、客户制造封装一体化需求，初步打造的 MEMS 封装测试能力，面向硅麦克风、压力、惯性、光学、RF、生物医疗等 MEMS 器件提供集成封装与测试服务，最终目标是实现为客户提供包括 IC 设计服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造、封装测试在内的一站式服务。

#### （四）可能面对的风险因素

##### 1、MEMS 业务收入下降风险

公司重大资产出售交割完成后，瑞典 Sillex 由公司全资子公司变为参股子公司，不再纳入公司合并报表。2023-2025 年，瑞典 Sillex 业务收入占公司 MEMS 业务收入的比例分别为 85.56%、82.69%、77.72%，本次控制权出售后，瑞典 Sillex 的收入不再纳入公司合并范围，静态情形下将导致公司 MEMS 业务收入规模大幅下降。

应对措施：公司将拓展及巩固赛莱克斯北京 MEMS 纯代工业务及展诚科技 IC 设计服务业务，进一步聚焦和投入于国内核心业务，集中资源重点发展并深化运营北京亦庄 MEMS 量产线，持续深入推进研发创新、科技合作，并加快拓展下游市场，积极响应客户需求，全力推进工艺开发及产品验证，持续推动项目的落地和产出，通过多种方式实现公司总体的营收增长及高质量可持续发展。

##### 2、业务协同不及预期风险

2025 年 9 月，公司完成对展诚科技 56.24%股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00%股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务。得益于集成电路行业总体行业的发展以及展诚科技在 IC 设计服务领域领先的行业地位，展诚科技 IC 设计服务业务发展势头良好，但公司收购展诚科技还旨在进一步拓展和深化在 MEMS 纯代工、IC 设计服务领域的战略布局，即依托展诚科技在 IC 设计服务领域积累的产业资源，以“MEMS+”模式推动双方业务发展，促进公司半导体服务产业生态协同，进一步提升公司综合竞争实力、行业地位和竞争力。若公司未能有效应对与展诚科技在企业文化、技术体系差异、业务整合管理等可能的多重协同整合影响因素，双方业务或将难以高效协同，因此在未来一段时间内，存在公司与展诚科技业务协同不及预期的风险。

应对措施：其一，公司将推进企业文化融合，通过共同培训、团队共建、利益共享等，形成积极向上、团结互信、目标一致的企业文化，为后续强化技术协同、优化整合管理提供坚实的文化支撑；其二，公司将强化技术协同，推动 IC 设计服务与 MEMS 纯代工业务的有机结合，形成业务的相互促进及客户导入；其三，公司将优化整合管理，制定分层推进的整合计划，建立常态化沟通机制，通过派驻管理人员、调整董事会结构等方式强化管控，推动双方在业务流程、管理体系上的高效衔接。

### 3、国际局势及汇率波动风险

自二战之后，特别是上世纪八九十年代以来，全球化发展日益加速，已成为时代发展的重要特征和显著标志，国家之间在经济、政治、文化、社会等方面的交流程度大幅提升，在加速科技进步和生产力发展的同时，也使得民族国家的利益面临着多元化的冲击和挑战，最终导致民族主义情绪的累积并在近年来显著抬头，右翼民粹主义、反全球化主义、贸易保护主义、本土主义等主张在全球，尤其是欧美国家泛起，引发国际局势紧张及日趋复杂化，对跨国经营的企业提出诸多新的挑战。公司同时持有境内外资产及业务，近年来直接源自境外营业收入的比例较高，2023-2025 年的比例分别为 50.04%、59.28%、60.88%，虽然公司在报告期后已完成瑞典 Silex 控制权出售的交割，但公司持有外币资产且部分原材料采购以及 MEMS 业务的部分机器设备采购仍涉及外币结算，日常涉及美元、欧元、瑞典克朗、日元、人民币等货币。因此，公司日常经营活动客观上面临着国际政治经济局势剧烈变化的风险，随之而来的还包括因汇率大幅波动对公司报表业绩（以人民币计算）产生较大影响的风险。

应对措施：公司将密切关注业务所涉及各主要币种的汇率变化，积极开展外汇衍生品交易进行风险对冲，尽可能地控制因汇率变动对公司财务及业务所造成的影响。

### 4、新兴行业的创新风险

公司 MEMS 主业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也是国家“十五五”规划中的科技前沿攻关领域，该产业技术进步及迭代迅速，要求行业参与者不断通过新技术/工艺的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术/工艺、新产品的投入不足，或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化，将会损害公司的技术优势与核心竞争力，从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响；此外，近年来，公司研发费用支出的绝对金额以及占营业收入的比重均处于高位，2023-2025 年，公司研发费用分别高达 3.57 亿元、4.55 亿元、3.93 亿元，占营业收入的比重分别高达 27.44%、37.75%、47.66%，而研发活动本身存在一定的不确定性，公司还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

应对措施：公司将一如既往地重视创新，在创新决策环节充分论证，以市场为第一导向，重视平衡创新的前瞻性与风险性；在创新实施环节优化创新组织机

制，充分发挥技术创新人员的积极性，提高实施过程中的管理效率，并重视财务资金的合理筹划与风险管理。

#### 5、行业竞争加剧的风险

公司 MEMS 主业直接参与全球竞争，竞争对手既包括博世、惠普、意法半导体、德州仪器等 IDM 企业，也包括 Teledyne、台积电、X-FAB、索尼、Atomica 等境外代工企业，以及芯联集成、广州增芯、上海先进、华虹宏力、华润微、士兰微、华鑫微纳等含 MEMS 业务的境内企业；IC 设计服务及 EDA 工具服务竞争对手包括创意电子、智原科技、灿芯股份、创耀科技、芯原股份、华大九天、概伦电子、广立微、行芯科技等。MEMS 属于技术、智力及资金密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来市场及产品竞争的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

应对措施：公司将继续加大研发投入与人才建设，在优势业务领域不断优化产品性能及丰富产品品类，扩大竞争优势；在新进业务领域，充分利用资本平台，发挥融资及扩张优势，尽快取得竞争优势。同时，注重分析公司产品在不同应用领域市场特点，提高市场响应效率，同等重视国内与国际市场。

#### 6、业务转型引致的管理风险

近年来，公司进行了重大战略转型，并于报告期内完成 IC 设计服务为主要业务的展诚科技收购，形成以半导体为核心的业务格局，MEMS 成为分处不同发展阶段、聚焦发展的战略性业务，公司国际化程度也日益提升。虽然公司已积累一定的管理经验，努力建立适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度，根据变化持续补充、加强国际化经营管理团队，但上述战略与业务层面的转型幅度较大、速度较快，对公司运营管理水平提出了较高要求；随着资产、业务、机构和人员规模的结构化扩张，资源配置和内控管理的复杂度不断上升，公司现有管理架构、流程和团队可能无法完全适应业务发展所带来的变化。公司存在管理水平不能适应业务转型的风险，存在管理制度不完善导致内部约束不健全的风险。

应对措施：公司将根据发展现状，及时优化治理结构与制度，通过集团化管理，明确分工与授权，提升管理效率，不断完善各岗位职责，强化管理层的责任和担当意识，增强对各子公司的有效管控。公司将考虑采用行之有效的激励机制，

吸引和留住优秀管理人才和核心骨干，并通过多种渠道引进人才，优化人才梯队结构，有效降低业务发展带来的管理风险。

#### 7、投资并购风险

近年来，公司已完成多起投资并购，投资控股或参股了多家公司、参与了部分产业基金的投资，但同时一些收购境外产线资产的交易也因非商业因素而遗憾失败。根据发展战略的需要，公司未来可能会实施新的并购重组或投资，以提高产业链及业务拓展效率，实现跨越式发展。如果将来选择的投资并购标的不恰当、所投资公司发展方向偏差、所合作核心团队出现不利变动，或者投资并购完成后未能做好资源及业务整合，以及再次受到非商业因素的影响，将存在投资并购的目标不能实现或不能完全实现的风险，亦存在着可能的商誉减值风险。

应对措施：公司将立足于长期发展战略规划，围绕公司所处行业的特点，结合公司实际情况，制定符合可持续发展的投资规划，并选择合适的并购方式对公司现有业务补充完善、优化整合，同时，加强投后管理工作，对已有的经营制度、管理模式和管理团队进行提升，保证公司的管理水平有效的满足各项业务的发展需要，促进公司治理、生产经营的协同发展，实现公司及并购标的高质量发展。

#### 8、政府补助风险

公司 MEMS 业务在国际上属于新兴科技创新领域，在我国也属于国家鼓励发展的高科技行业（于 2021 年 3 月被纳入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中的科技前沿攻关领域）。近年来，公司已陆续获得数笔与主营业务相关的政府补助。2023-2025 年，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 1.07 亿元、0.21 亿元、0.06 亿元，占当期利润总额绝对值的比例分别为 335.69%、8.27%、0.46%，对 2023-2025 年公司经营业绩构成重大影响。虽然通过政策支持、资金补贴、税收优惠和低息贷款等措施大力支持半导体行业（尤其是半导体制造环节）的发展属于国际通行做法，但公司在后续财务报告期间能否持续取得政府补助、涉及多少金额、会计处理方法等均存在不确定性，因此公司存在经营业绩受政府补助影响、影响大小不确定的风险。

应对措施：一方面，公司将努力提升产能及产能利用率、提升良率，扩大半导体业务体量，提高主营业务盈利能力；另一方面，公司将继续积极争取适用于主营业务的政府补贴及税收优惠。

特此报告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026年3月26日